





非破壊検査に関するご案内

JASPA 株式会社

https://www.jaspa.co.jp info@jaspa.co.jp



共同工場運営による航空機部品一貫生産

弊社では2017年1月に、国際航空宇宙産業特殊工程認証プログラム(Nadcap)の蛍光浸透探傷検査の認証を取得し、共同工場における航空機部品の一括受注製造だけでなく、非破壊検査を含めた一貫生産体制を確立しました。

非破壊検査概要



◎取得認定

特殊工程名称	設備番号	検定、認可 適用スペック番号	検定、認定の種類 (タイプ・クラス等)	検定、認定 機関
蛍光浸透探傷検査	МаШ(D) МаШ(В)	AC7114 AC7114/1	Nadcap	PRI
蛍光浸透探傷検査	МаШ(D) МаШ(В)	ASTM E1417 NAS410	Type1 MethodD Level3 Type1 MethodD Level4	川崎重工業株式会社 航空宇宙システム カンパニー KHI
蛍光 浸透 探傷検査	MaⅢ(D) MaⅢ(B) システム認定	J-ISAJT-A002	GRADE 3 検査員認定システムを含む PW1100G-JM 部品限定	川崎重工業株式会社 航空宇宙システム カンパニー KHI
蛍光浸透探傷検査	МаШ(D) МаШ(В)	KT-8002 KQ-2501(PT)	Type1 MethodD Level3	川崎重工業株式会社 航空宇宙システム カンパニー KHI
蛍光浸透探傷検査	システム認定	ASTM E1417 NAS410	ASTM E1417/E1417M: 感度レベル 2 もしくは 3 NAS410:レベル 2,3	株式会社 JAMCO
磁粉探傷検査	U20A-6KD0B 3Z176	KT-8001 KQ-2501(MT)	-	川崎重工業株式会社 航空宇宙システム カンパニー KHI



◎検査員

特殊工程名称	作業レベル	検査員数	認証規格	認定機関
蛍光浸透探傷検査	レベル 3	2名	NAS410	JASPA(株)
	KHI supplier Level 3		J-ISAJT-A002	NANDTB
			KQ-2501	KHI
蛍光浸透探傷検査	レベル 2	4名	NAS410	JASPA(株)
			J-ISAJT-A002	
			KQ-2501	
磁粉探傷検査	レベル 3	1名	NAS410	JASPA(株)
	KHI supplier Level 3		KQ-2501	NANDTB
				KHI
磁粉探傷検査	レベル 2	1名	NAS410	JASPA(株)
			KQ-2501	

◎設備概要





<浸透探傷検査設備>

・MAIII(A) Aライン Type1 メソッドA レベル 2,3 Form a

・MAIII(D) Dライン Type1 メソッドA,D レベル 2,3,4 Form a

・MAIII(B) Bライン Type1 メソッドA,D レベル2,3,4 Form a

<洗浄設備>

・アルカリ/酸洗浄装置

<磁粉探傷検査設備>

• U20A-6KD0B 3Z176



MAⅢ(D) D ライン マークテック製

処理可能寸法: 1200(L)×1200(W)×550(H)mm 処理可能重量:約100kg



<浸透ブース> 固定式ブラックライト

浸透液スーパーグロー蛍光浸透液

ターンテーブル Φ1400mm

適用方法 浸漬法、スプレー法、刷毛塗法



<前洗浄ブース> 固定式ブラックライト

ターンテーブル Φ 1400mm

洗浄ガン 洗浄水圧力: 0.150-0.270MPa 洗浄水除去用エアブロー エアブロー圧力: 0.150-0.170 MPa



<本洗浄ブース>

ターンテーブル Φ 1400mm

洗浄ガン洗浄水圧力: 0.150-0.270MPa洗浄水除去用エアブローエアブロー圧力: 0.150-0.170 MPa



<乳化槽>

室内寸法 1500(L)×1400(W)×600(D)mm

昇降リフターにて槽内浸漬をし、乳化剤を塗布する



<乾燥装置>

熱風循環式

室内寸法 1500(L)×1500(W)×600(H)mm

設定温度 62℃



<現像装置>

室内寸法 1500(L)×1500(W)×550(H)mm

適用方法 エアフライング法

乾式現像剤 スーパーグロー現像剤 D700

現像時間 10-240 分

現像剤除去エアブロー エアブロー圧力 0.034MPa 以下



<検査室>

ターンテーブル Φ1400mm

固定式ブラックライト 紫外線強度:1200-7000μW/cm²

照度:20Lux 以下

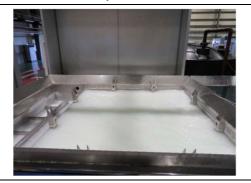
ハンドブラックライト 紫外線強度:1200-7000μW/cm²

照度: 20Lux 以下



アルカリ洗浄装置

処理可能寸法: φ1254mm×800(H)mm 処理可能重量:約 200kg 表面状態:機械加工面



<第一アルカリ洗浄槽>

内寸 1600(W)×1500(D)×1100(H)mm 洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm

内容量 3040L

使用溶液 スーパー・ビー300LF(SB300LF)

設定温度範囲 20~70℃



<アルカリ回収槽>

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm

内容量2640L使用溶液再生水



<第二アルカリ洗浄槽>

内寸 1600(W)×1500(D)×1100(H)mm 洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm

内容量 3040L

使用溶液 -

設定温度範囲 20~70℃



<湯洗槽>

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm

内容量2640L使用溶液再生水設定温度範囲20~80℃



<乾燥機>

乾燥内寸法 1600(W)×1500(D)×1100(H)mm

熱風循環式 設定温度 常犯

常温~350℃



酸洗浄装置

処理可能寸法: φ1254mm×800(H)mm 処理可能重量:約 200kg 表面状態:機械加工面



<酸洗浄槽>

内寸 1600(W)×1500(D)×1100(H)mm 洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm

内容量 3040L 設定温度範囲 20~34℃

材質 SUS304 槽内面テフロンコーティング



<酸回収槽>

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm

内容量2640L使用溶液再生水

材質 SUS304 槽内面テフロンコーティング



<酸水洗槽>

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm

内容量2640L使用溶液再生水



<酸湯洗浄槽>

洗浄有効寸法 1500(W)×1400(D)×850(H)mm

内容量2640L使用溶液再生水設定温度範囲20~80℃



設備詳細

MAⅢ(A) Aライン マークテック製

処理可能寸法:920(L)×920(W)×500(H)mm 処理可能重量:約100kg



<浸透槽・排液台>

浸透液スーパーグロー蛍光浸透液処理有効寸法1000(L)×1100(W)×500(D)mm

適用方法 浸漬法、刷毛塗法



<洗浄槽>

固定式ブラックライト

洗浄ガン 洗浄水圧力: 0.150-0.270MPa

洗浄水除去用エアブロー エアブロー圧力: 0.150-0.170 MPa



<乾燥装置>

熱風循環式

室内寸法 1000(L)×1100(W)×700(H)mm

設定温度 62℃



<現像装置>

室内寸法 1000(L)×1100(W)×700(H)mm

適用方法 エアフライング法

乾式現像剤 スーパーグロー現像剤 D700

現像時間 10-240 分

現像剤除去エアブロー エアブロー圧力 0.034MPa 以下



<検査室>

ハンドブラックライト 紫外線強度:1200-7000μW/cm²

照度:20Lux 以下



MAⅢ(B) Bライン マークテック製

処理可能寸法:1200(L)×1200(W)×550(H)mm 処理可能重量:約100kg



<浸透ブース> 固定式ブラックライト

浸透液 スーパーグロー蛍光浸透液

ターンテーブル Φ1400mm

適用方法 浸漬法、スプレー法、刷毛塗法



<洗浄ブース> 固定式ブラックライト

ターンテーブル Φ1400mm

洗浄ガン洗浄水圧力: 0.150-0.270MPa洗浄水除去用エアブローエアブロー圧力: 0.150-0.170 MPa



<乾燥装置> 熱風循環式

室内寸法 1500(L)×1500(W)×600(H)mm

設定温度 62℃



<現像装置>

室内寸法 1500(L)×1500(W)×550(H)mm

適用方法 エアフライング法

乾式現像剤 スーパーグロー現像剤 D700

現像時間 10-240 分

現像剤除去エアブロー エアブロー圧力 0.034MPa 以下



<検査室>

ターンテーブル Φ1400mm

固定式ブラックライト 紫外線強度:1200-7000μW/cm²

照度: 20Lux 以下

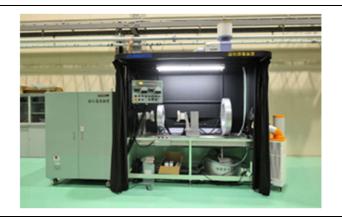
ハンドブラックライト 紫外線強度:1200-7000μW/cm²

照度: 20Lux 以下



U20A-6KD0B 3Z176 磁粉探傷装置 マークテック製

処理可能寸法: φ400mm ×1300(L)mm 処理可能重量:約 20kg



磁化方式 軸通電法、コイル法選択による

単一磁化

最大磁化電流 AC4000A(波高值)≒AC3000A(実効値)

DC6000A(平均值 三相全波)

制御方式 無接点・無段階 SCR 位相制御方式

【参考】その他保有設備



○X 線装置

最大出力 450kV

X 線照射範囲 φ 1056 mm

X線発生装置、X線管、X線照射室等から構成され、 外観から観察できない内部構造を観察するため、

X線フィルムでの透視検査、解析が可能



○立型サーフェスブローチ盤

引抜力 160 kN 最大行程 2700mm

切削速度 0.5~20 m/min,50HZ戻り速度 ~20 m/min,50HZ

最大 NC 軸数 5

加工可能寸法 φ 800 mm



○ショットピーニングマシン

処理目的 ピーニング

タイプ 回転テーブルおよびロボット式

処理可能寸法 最大: φ1300mm×280(H)mm

最小: φ680mm×67(H)mm

研削材 スチールショット NB♯40(0.4mm)

ノズル脱着方式 オートチャージ式



会社概要

会 社 名 : JASPA 株式会社

設 立 : 2004 年 4 月 14 日

資 本 金 : 4,000 万円

所 在 地

(本社)神奈川県横浜市中区真砂町 4-43 木下商事ビル 3階

(営業本部)神奈川県横浜市中区真砂町 4-43 木下商事ビル 3階

(新潟工場)新潟市西蒲区漆山字四十歩割 8460

代表 者:代表取締役/阿部和幸

お問い合わせ先

営業本部:〒231-0016 神奈川県横浜市中区真砂町 4-43

木下商事ビル3階

電話番号:045-264-4494 Fax 番号:045-264-4493

Mail: info@jaspa.co.jp URL: https://www.jaspa.co.jp



